

2019.4.1 ~ 2019.9.30

2019年12月発行

特集

株主様アンケート結果のご報告とご質問

株主様工場見学会

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

証券コード 5384



お客様目線の実践

パウダー&サーフェスカンパニーへの進化

「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当事者意識とやり抜く力の確立

革新への挑戦



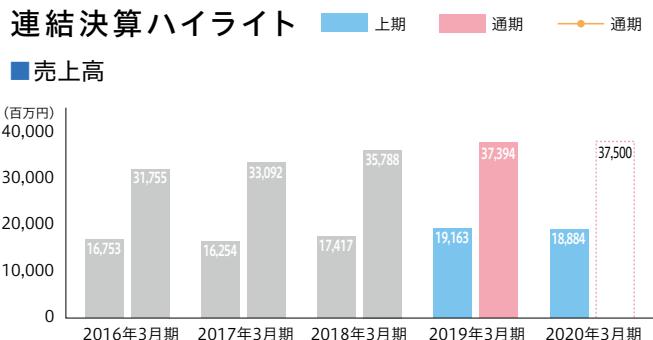
技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした
 さまざまな産業で活かされています。
 フジミはお客様にあらゆる製品を
 磨いていただくことで、
 人々が快適に暮らせる未来の創造に
 貢献します。

代表取締役社長

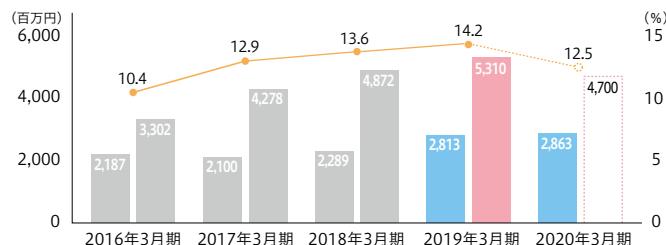
関 敬史

連結決算ハイライト



■ 営業利益・営業利益率

折れ線グラフ: 営業利益率 (右軸)



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

》 上期を振り返って

当社グループを取り巻く環境は、世界各国において政治・政策面での先行き不透明感がある中で、米国では緩やかながら景気拡大が持続しました。一方、日本・欧州では景気の足踏み感が強まり、中国では貿易摩擦の影響を受け景気は減速傾向にありました。また、世界半導体市場は、ロジックデバイスでは最先端製品の生産が本格化しつつあるものの、メモリデバイスでは需要減退による稼働調整局面が続き、シリコンウェハー市場も軟調に推移しました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めました結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高 18,884 百万円（前年同期比 1.5%減）、営業利益 2,863 百万円（前年同期比 1.8%増）、経常利益 2,974 百万円（前年同期比 2.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益 2,212 百万円（前年同期比 5.5%減）となりました。

トピックスとしまして、お客様との関係では大手半導体シリコンウェハーメーカーの2社よりサプライヤーアワードを受賞しました。当社の経営方針の一つであるお客様目線の実践が評価された結果であると実感しております。引き続きお客様の視点に立った製品開発とものづくりを推進してまいります。

》 成長に向けた取り組み

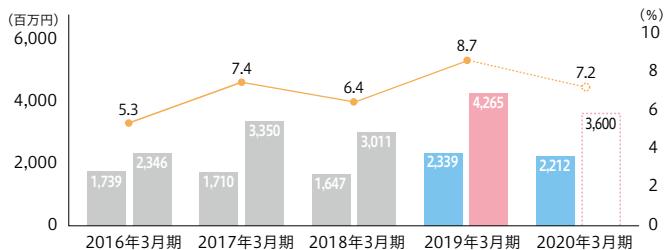
当社は研磨材中心の事業領域をパウダー（粉）とサーフェス（表面）に広げ、業態の進化をめざすべく、研究開発を推進しております。この度、新たなパウダーとしてリン酸チタン粒子を開発しました。開発した粒子は高白色・板状で、粒子径・厚みが揃っていることが特長であり、当社はこのリン酸チタン粒子をフィラーや塗料の添加剤などのさまざまな用途に展開していきたいと考えております。

また、新たな成長に向けた取り組みとして2015年11月に設立したコーポレートベンチャーキャピタルファンド（CVCファンド）では、これまでにベンチャー企業6社に投資を実行しておりますが、当上期中に既出資先のベンチャー企業1社に追加投資を行いました。当該ベンチャー企業へは、CVCファンドからの出資と同時に、フジミ本体からも出資を実行しております。出資先はいずれも当社が得意とする整粒技術や研磨技術を活かし、ともに研究開発を進めてゆけるベンチャー企業です。当社は投資先ベンチャー企業とのシナジーを創出し、事業の更なる拡大と新規事業機会の探索に繋げてまいります。

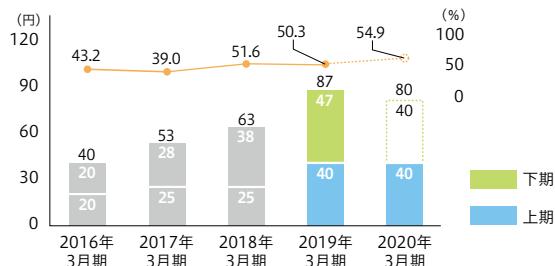
最後になりますが、CSR活動においては、これまでの活動に加え、両立支援、女性活躍推進等にもより一層力を注ぎ、持続的な企業価値増大を目指してまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■ 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益・ROE 折れ線グラフ:ROE(右軸)



■ 配当金・連結配当性向 折れ線グラフ:連結配当性向(右軸)



特集

株主様アンケート結果のご報告とご質問

毎号、株主通信のアンケートには、多くの株主様からたくさんのお声を頂戴しています。ご回答いただきました株主の皆様におかれましては、お忙しい中ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

今号では、株主様にアンケート結果のご報告をするとともに株主様からのご質問にお答えいたします。

※過去の株主通信は当社ホームページよりご覧いただけます。

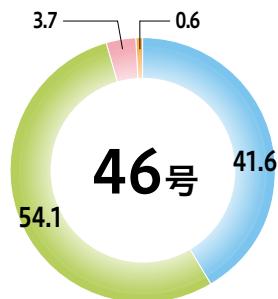
<http://www.fujimiinc.co.jp/ir/library/report.html>



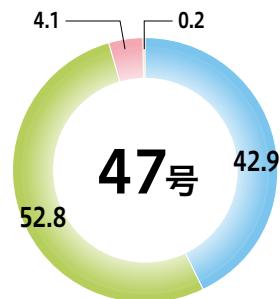
	46号	47号	48号
調査対象	4,081	3,660	4,063
回答数	972	1,232	1,159
回答率	23.8%	33.7%	28.5%

調査方法：ハガキによる調査

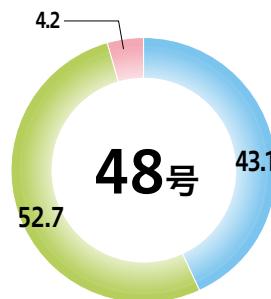
株主通信のご評価



「働きがいと働きやすさの醸成」
に向けて



誌上工場見学会、
FUJIMI CORPORATION
30周年を迎えました

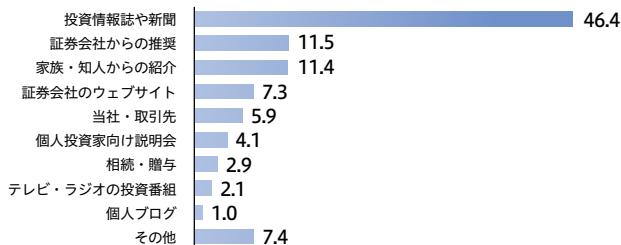


フジミの製品が
使用されるシーン

- 満足
- やや満足
- やや不満足
- 不満、回答なし

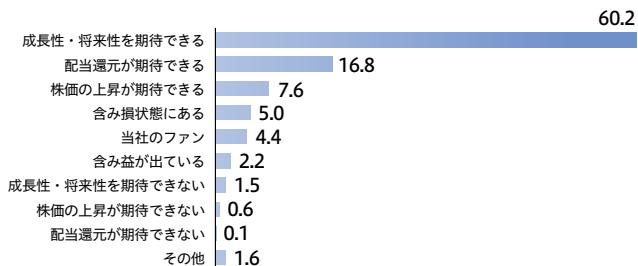
過去3号いずれも「満足」、「やや満足」の合計が9割以上とご評価いただきました。引き続き株主様にご満足いただける冊子づくりに努めてまいります。

当社を知るきっかけとなったものは何ですか？



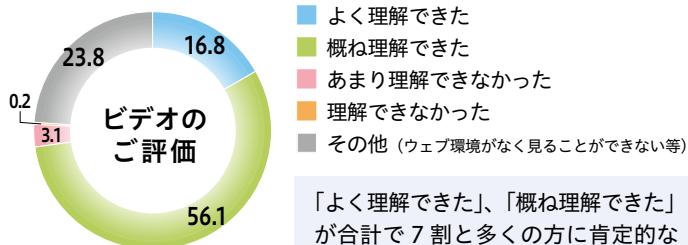
「投資情報誌や新聞」がきっかけという人が46.4%を占めております。

当社株式の保有方針を選択した理由



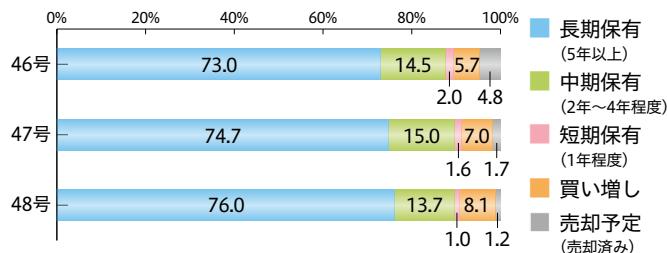
「成長性・将来性を期待できる」、「配当還元が期待できる」が合計で7割を超えており、当社に対する期待の高さを認識しました。

会社案内ビデオリニューアルのご評価



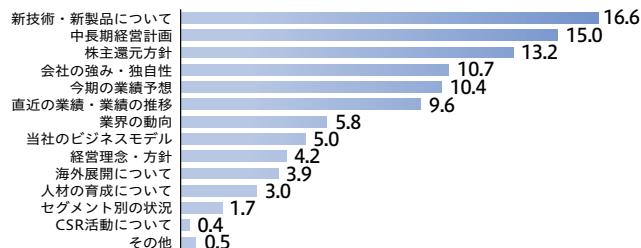
「よく理解できた」、「概ね理解できた」が合計で7割と多くの方に肯定的なご評価をいただきました。

当社株式の今後の保有方針



長期保有を方針とする人の割合が増えております。

当社の個人投資家説明会で、お聞きになりたいことは何ですか？



「新技術・新製品について」、「中長期経営計画」、「株主還元方針」に高い関心をいただいております。今後の説明会では、可能な限りご紹介いたします。

自由記述コメント

- 会社案内ビデオが30分と長い。短いバージョンもあった方がよい。
- 当社ウェブサイト上にダイジェスト版（10分）を用意しました。詳細は10ページをご覧ください。
- IR活動や株主アンケートの結果行った改善点などありましたら掲載してもらいたい。
- ホームページや株主通信を通じご紹介してまいります。

質問 1 分野別の世界シェアを教えてください。

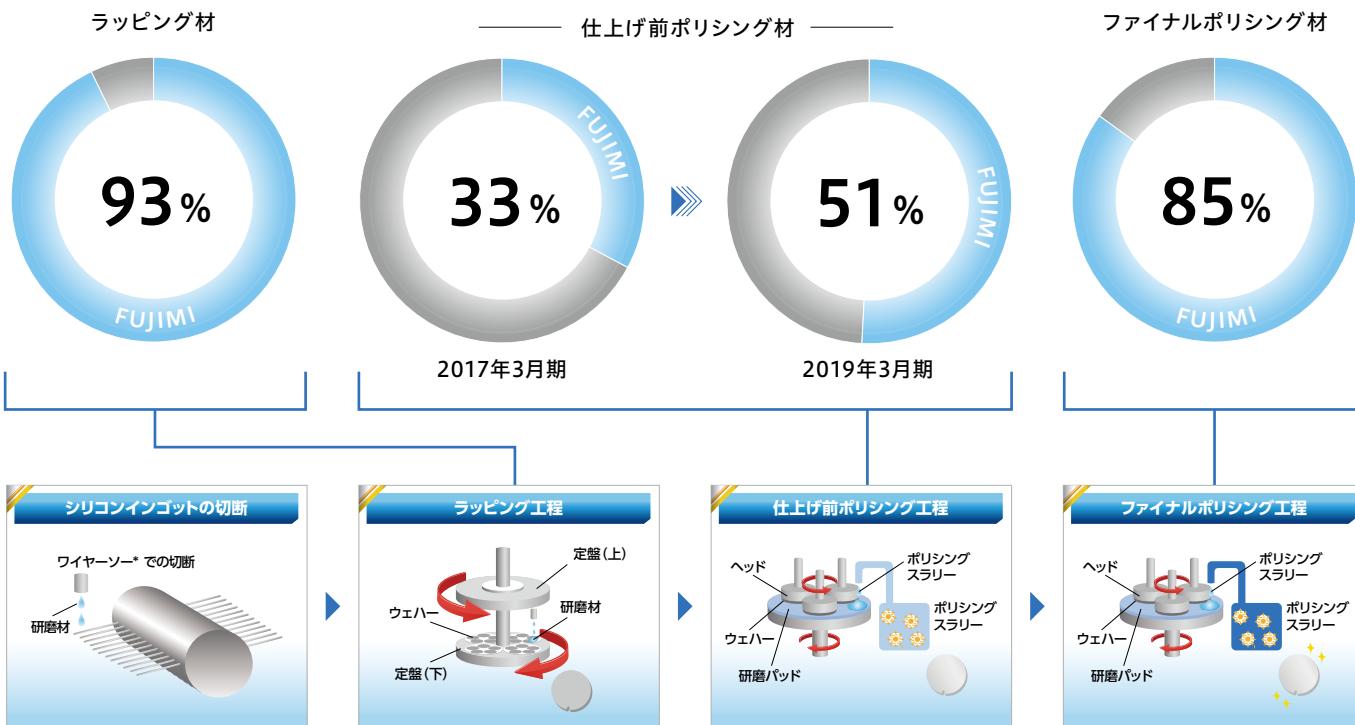
当社の基幹事業にシリコン事業とCMP事業がございます。

シリコン事業は、スマートフォンなどに使用されている半導体の基板として用いられているシリコンウェハー向け研磨材を製造販売しております。

当社の精密研磨材は、半導体シリコンウェハーの製造プロセスで切断工程、ラッピング工程、複数のポリシング工程に使用されます。その中でラッピング材*、ファイナルポリシング材*はいずれも世界シェアの約9割を占めております。

また、仕上げ前のポリシング材では、2017年3月期の世界シェアは約3割でしたが、配線間隔の微細化に伴いお客様の要求する品質レベルが高くなった結果、当社製品の性能が評価され、2019年3月期では約5割にまで伸ばしております。

半導体デバイス製造工程における当社の世界シェア（自社統計 2019年3月期）



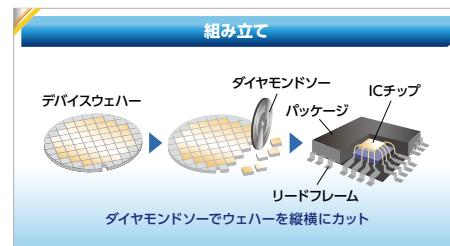
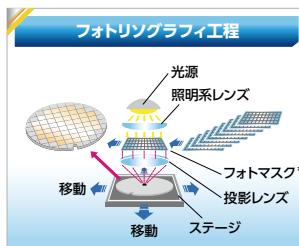
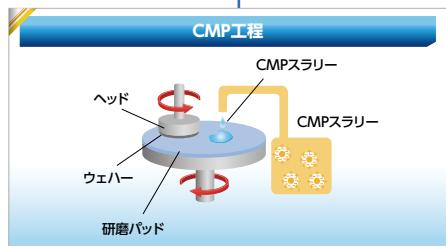
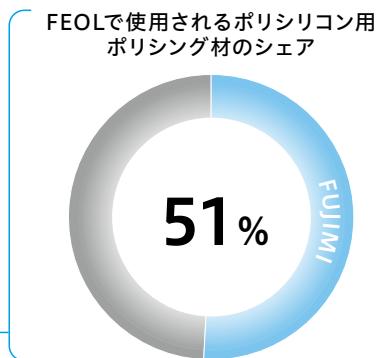
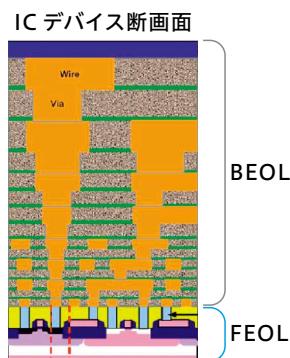
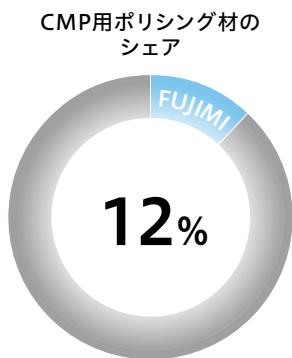
***ワイヤーソー** 細いワイヤーに研磨材と加工液を混ぜたスラリーをかけながら切断加工する方法。

***ラッピング材** シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。

***ファイナルポリシング材** ファイナルポリシング工程で使われる鏡面仕上げ研磨スラリー（液体研磨材）。

もう一つの基幹事業であるCMP事業は、半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売しております。CMP（化学的機械研磨）用製品群は、シリコンウェハー用のファイナルポリシング材のノウハウを応用して開発され、トランジスタ素子形成工程（FEOL*）や多層配線工程（BEOL*）に対応した製品を揃えております。

当社は、お客様と同等レベルのCMP装置や評価装置を導入し、できる限りお客様と同じ条件で研究開発を進めています。その結果、現在の世界シェアは約12%と2位グループに位置づけておりますが、FEOLで使用されるポリシリコン用ポリシング材に限れば当社シェアは約5割を占めております。半導体デバイスの微細化や3次元構造などの技術革新に伴い、CMP工程数は増加しており、当社製品を使用する機会が広がっています。



ウェハーをチップに切り分け、パッケージングして出荷します。

*FEOL Front End Of Lineの略。

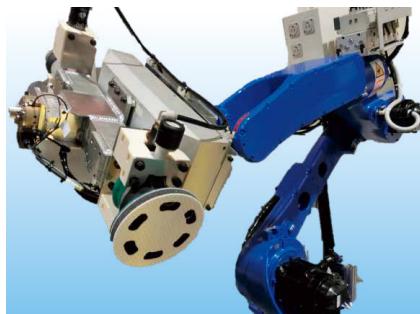
*BEOL Back End Of Lineの略。

*フォトマスク 電子部品の回路パターン等を被転写対象に転写する際の原版。

質問 2 新製品・新技術に関して教えてください。

当社では、従来の常識にとらわれない新たな発想のもと、これまでにない表面研磨技術の研究開発を進めています。その一つがロボットによって3次元の加工対象物を精密に研磨する技術です。当社ではこれまで半導体基板をはじめとする、平面の高精度研磨を追求して参りましたが、弊社に寄せられる研磨ニーズは平面に限定されるものではありません。

3次元表面を高精度で研磨することは容易ではありませんが、世の中に先駆けて技術を構築することで、新たな市場が拓けると考えております。すでに全自動ロボット研磨機の開発や、3次元表面の高精度研磨に適した新たな研磨材の開発が進んでおり、実用化段階を迎えています。



全自動ロボット研磨機



ロボット研磨イメージ



開発した研磨材・3D研磨パッド



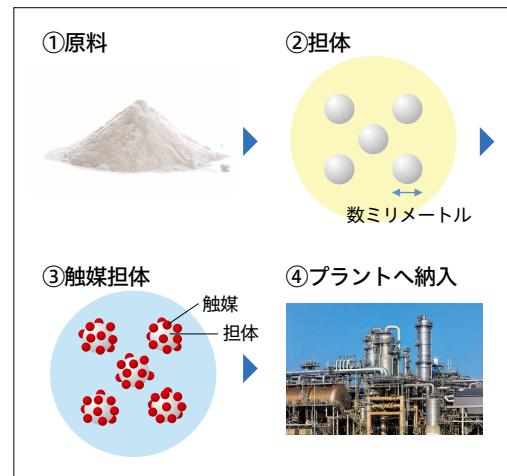
研磨対象例

質問 3 半導体以外の用途について教えてください。

PCの記憶装置に用いられるハードディスクや眼鏡用プラスチックレンズ、LED用のサファイア基板などさまざまな用途に当社の研磨材は使用されています。

研磨材以外では、一例として触媒担体に使用される担体という製品があります。

担体は、化学的に安定した物質で、吸着や触媒活性を示し、他の物質を固定する基材となるもので、当社の担体は主に、石油精製や石油化学の分野で使用されています。製造工程は数百マイクロメートルの粉に複数の副原料を配合し、数ミリメートルの大きさまで造粒します。造粒後は、乾燥、焼成、検査工程を経て、お客様である触媒メーカーに担体を出荷します。その後、お客様のところで触媒として利用する金属の微粒子を担体に付着させて触媒担体として、石油精製や石油化学製品を生産するプラントに納入されます。



「株主様工場見学会」のご報告

当社へのご理解をより一層深めていただくため、「株主様工場見学会」を10月11日（金）に開催しました。当日は、社長の関による会社紹介のあと、国内主力工場である各務原工場の概要について説明し、主要製品であるFOとGLANZOXの製品製造ラインをご見学いただきました。見学の際には、実際に作業を行う現場の従業員が工程を説明しました。

今回初の試みとして研磨体験をご用意し、株主様に当社製品への理解を深めていただきました。

開催概要

日時：2019年10月11日（金）

見学場所：各務原工場
（岐阜県各務原市）

来場者：23名

対象：2019年3月31日現在、
当社株を100株以上ご
所有の株主様より抽選

※株主様アンケートハガキで募集

各務原工場

所在地
〒504-0927 岐阜県各務原市上戸町7-1-8

主な生産品名
FO、GLANZOX、PLANERLITE、
COMPOL、DISKLITE 等



会社説明



工場説明



工場見学

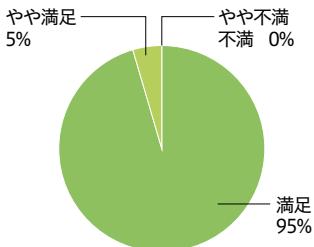


研磨体験

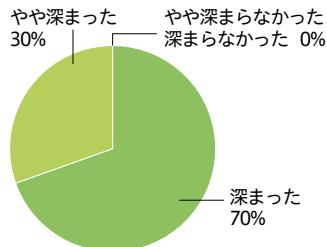


工場見学会後のアンケート集計結果のご報告

工場見学会は満足のものでしたか？



当社の事業内容について理解が深まりましたか？



ご参加いただきました株主様からのご意見・ご感想

- 研磨の体験が良かった。
- 他工場も見学させてほしい。
- 複数回見学会を開催し、より多くの人が見られるようにしてほしい。
- 写真や映像ではなく、自分の目で現場を見ることができた。今後のますますの発展を期待する。

株主様から直接ご意見を伺う貴重な機会となりました。引き続きIR活動のさらなる充実に努めてまいります。

用途別の動き

シリコンウェハ用

売上構成比 33.5%

小口径シリコンウェハ市場の減速により、ラッピング材の売上高は1,834百万円(前年同期比15.7%減)となりました。一方、ポリシング材につきましては、当社製品の採用が拡大したことから、売上高は4,486百万円(前年同期比4.3%増)となりました。

半導体基板となるシリコンウェハを高精度に平坦化・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。

■ 売上高 (単位: 百万円)



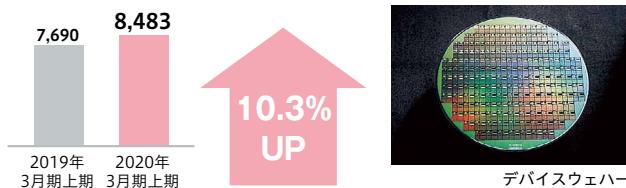
CMP用

売上構成比 44.9%

メモリデバイス市況は停滞したものの、最先端半導体デバイス向け製品の販売が増加したことにより、売上高は8,483百万円(前年同期比10.3%増)となりました。

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。

■ 売上高 (単位: 百万円)



ハードディスク用

売上構成比 5.8%

SSD(ソリッドステート・ドライブ)への置き換えによる市場の縮小及び顧客の生産プロセスの変更の影響により、売上高は1,093百万円(前年同期比14.4%減)となりました。

パソコンやデータ保管をするサーバーの記憶装置に搭載されているハードディスク用基板の研磨材を提供しております。

■ 売上高 (単位: 百万円)



一般工業用・溶射材等

売上構成比 15.8%

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、売上高は1,740百万円(前年同期比21.3%減)、その他につきましては、1,246百万円(前年同期比17.2%減)となりました。

多種多様な用途向けに研磨材や材料を提供しております。また、鉄鋼、航空機及び半導体などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。

■ 売上高 (単位: 百万円)



シルトロニック社より サプライヤーアワードを受賞

2019年6月に大手半導体シリコンウェハーメーカーであるドイツのシルトロニック社よりサプライヤーアワードを受賞しました。表彰は2年に一度行われ、これまでに当受賞を含め合計5回受賞しております。



SKシルトロン社より ベストパートナーアワードを受賞

2019年10月に大手半導体シリコンウェハーメーカーである韓国のSKシルトロン社よりベストパートナーアワードを受賞しました。これまでに当受賞を含め合計2回受賞しております。



会社案内映像ダイジェスト版を制作

2019年4月1日にリニューアルしました会社案内映像のダイジェスト版（10分）を新たに制作しました。

▼会社案内映像ダイジェスト版はこちら
<http://www.fujimiinc.co.jp/company/video.html>



野村IR資産運用フェア2019 出展のお知らせ

2019年12月20日（金）、21日（土）の2日間、東京渋谷のベルサール渋谷ガーデンにて開催される野村IR資産運用フェア2019に出展します。是非、当社ブースへお立ち寄りください。

▼野村IR資産運用フェア2019の詳細はこちら
<https://fair.nomura-ir.co.jp/ja/index.html>

連結財務諸表

連結損益計算書

	前第2四半期 連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
売上高	19,163	18,884
売上原価	11,255	10,759
売上総利益	7,908	8,124
販売費及び一般管理費	5,095	5,261
営業利益	2,813	2,863

営業外収益		
受取利息	56	61
為替差益	140	7
その他	56	50
営業外収益合計	253	119
営業外費用	9	7
経常利益	3,056	2,974

税金等調整前四半期純利益	3,056	2,974
法人税、住民税及び事業税	797	778
法人税等調整額	△79	△15
四半期純利益	2,339	2,212
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,339	2,212

(単位：百万円)

売上高

CMPで最先端半導体デバイス向け製品の販売が増加するも、CMP以外は中国の景気減速等の影響を受け販売が減少したことから、売上高は前年同期比1.5%減の18,884百万円となりました。

営業利益

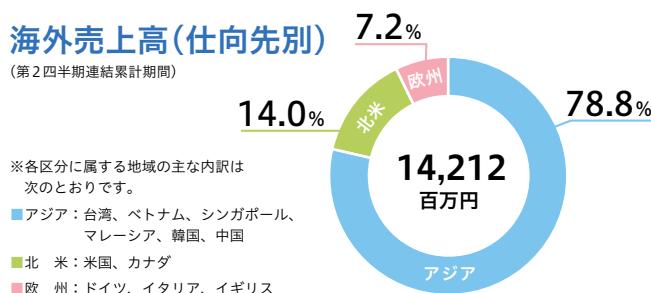
販売費及び一般管理費が増加するも、製品構成が良化し、前年同期比1.8%増の2,863百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益

前年同期比5.5%減の2,212百万円となりました。

海外売上高(仕向先別)

(第2四半期連結累計期間)



海外売上高

	前第2四半期 連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
海外売上高	14,201	14,212
連結売上高	19,163	18,884
連結売上高に占める割合	74.1%	75.3%

(単位：百万円)

連結貸借対照表

前 当第2 四半期
連結会計年度 連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,852	23,768
受取手形及び売掛金	8,001	7,941
有価証券	3,500	2,299
たな卸資産	7,253	7,347
その他	634	531
貸倒引当金	△26	△17
流動資産合計	41,216	41,871
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	7,494	7,201
その他(純額)	6,383	7,251
有形固定資産合計	13,877	14,453
無形固定資産	400	396
投資その他の資産		
投資有価証券	1,455	1,609
繰延税金資産	777	787
その他	130	136
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	2,354	2,523
固定資産合計	16,632	17,373
資産合計	57,848	59,245

(単位：百万円)

前 当第2 四半期
連結会計年度 連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年9月30日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,517	2,752
未払法人税等	789	686
賞与引当金	1,073	1,152
役員賞与引当金	—	53
株式給与引当金	294	—
その他	2,172	2,796
流動負債合計	6,848	7,441
固定負債		
退職給付に係る負債	701	716
株式給与引当金	15	15
その他	51	102
固定負債合計	768	835
負債合計	7,616	8,276
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,570	5,570
利益剰余金	45,031	46,067
自己株式	△5,641	△5,450
株主資本合計	49,714	50,941
その他の包括利益累計額	517	27
純資産合計	50,231	50,969
負債純資産合計	57,848	59,245

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて1,054百万円増加し、3,225百万円の収入となりました。これは主に、法人税等の支払額の増加があったものの、仕入債務が増加したこと及び売上債権が減少したこと等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は、前年同期に比べて1,408百万円減少し、20百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出があったものの、定期預金の払戻による収入が増加したこと及び定期預金の預入による支出が減少したこと等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は、前年同期に比べて240百万円増加し、1,192百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が増加したこと等によるものであります。

配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を50%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、中間配当は1株につき40円とし、年間配当金は、1株につき80円とする予定です。

連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2 四半期 連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2 四半期 連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
●営業活動によるキャッシュ・フロー	2,170	3,225
●投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,387	20
●財務活動によるキャッシュ・フロー	△952	△1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額	152	△196
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△17	1,856
現金及び現金同等物の期首残高	23,336	22,559
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,319	24,415

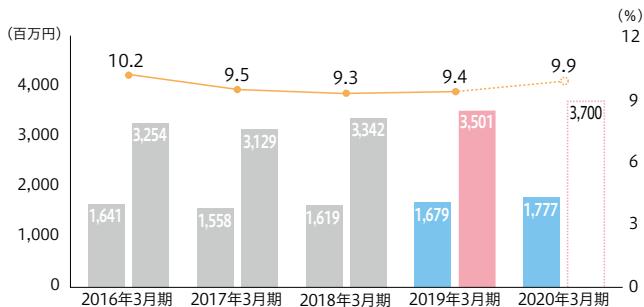
(単位:百万円)

■ 上期 ■ 通期 ※2020年3月期通期予想値

■ 設備投資



■ 研究開発費・売上高比 折れ線グラフ: 売上高比 (右軸)



■ 減価償却費



株式情報 2019年9月30日現在

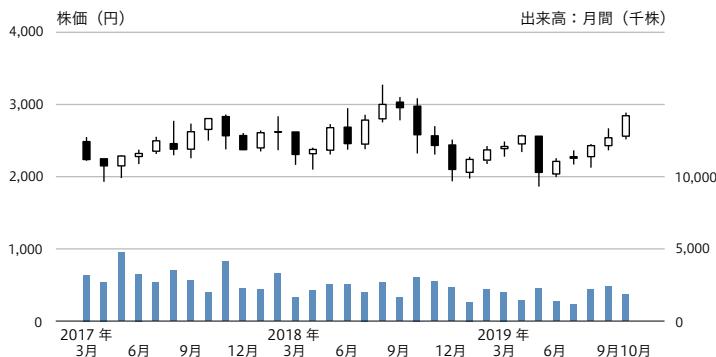
株式の状況

株式数 発行可能株式数	120,000千株
発行済株式総数	28,699千株
株主数	5,655名

大株主(株主名)	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社コマ	3,743	13.0
株式会社フジインコーポレーテッド	3,667	12.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,804	6.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,496	5.2
株式会社三菱UFJ銀行	728	2.5
越山 勇	717	2.4
フジミ取引先持株会	660	2.3
株式会社かんぽ生命保険	645	2.2
日本生命保険相互会社	639	2.2
一般財団法人越山科学技術振興財団	600	2.0

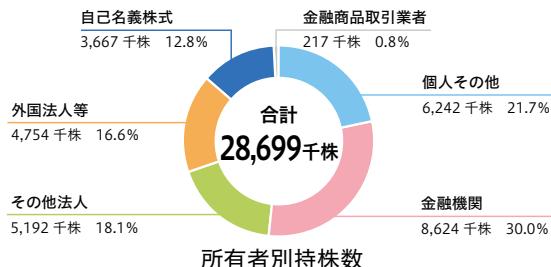
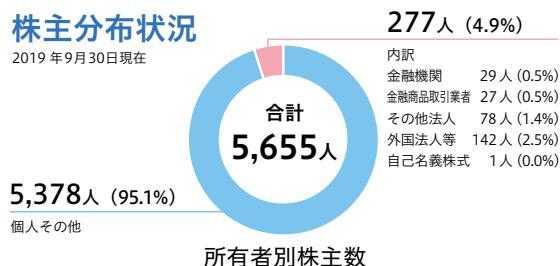
*持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2以下を切り捨てしています。

株価及び出来高の推移



株主分布状況

2019年9月30日現在



役員

2019年
9月30日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰
取締役	大脇 寿樹
取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
取締役	浅井 侯序*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

(*印は社外取締役) (**印は社外監査役)

会社データ 2019年9月30日現在

商号	株式会社フジインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	888名(個別616名)

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日
配当金受領株主確定日	期末配当金：3月31日 中間配当金：9月30日
単元株式数	100株
定時株主総会	毎年6月
公告方法	電子公告 (http://www.fujimiinc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 及び照会先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話無料)

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等

証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。

証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合せください。

特別口座管理機関
連絡先

日本証券代行株式会社
〒168-8620

東京都杉並区和泉二丁目8番4号
日本証券代行株式会社 代理人部
電話 0120-707-843 (通話無料)

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部経営企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2019 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



この印刷物は、適切に管理された森林で生産された木材を使った環境配慮型のFSC®認証紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。